

2024-2030年中国半导体设备产业发展现状与产业竞争格局报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国半导体设备产业发展现状与产业竞争格局报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/416392.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国半导体设备产业发展现状与产业竞争格局报告》共八章。首先介绍了半导体设备行业市场发展环境、半导体设备整体运行态势等，接着分析了半导体设备行业市场运行的现状，然后介绍了半导体设备市场竞争格局。随后，报告对半导体设备做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体设备行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体设备产业有个系统的了解或者想投资半导体设备行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：半导体设备行业概念界定及发展环境剖析

1.1 半导体设备的概念界定及统计口径说明

1.1.1 半导体设备的概念界定

1.1.2 半导体设备的分类

1.1.3 本报告数据来源及统计口径说明

1.2 半导体设备行业政策环境分析

1.2.1 行业监管体系及机构

1.2.2 行业规范标准

(1) 现行标准

(2) 即将实施标准

1.2.3 行业发展相关政策汇总及重点政策解读

(1) 行业发展相关政策汇总

(2) 行业发展重点政策解读

1.2.4 行业发展中长期规划汇总及解读

(1) 行业发展中长期规划汇总

(2) 行业发展中长期规划解读

1.2.5 政策环境对半导体设备行业发展的影响分析

1.3 半导体设备行业经济环境分析

- 1.3.1 宏观经济现状
 - (1) GDP发展分析
 - (2) 固定资产投资分析
 - (3) 工业经济运行分析
- 1.3.2 经济转型升级发展分析
- 1.3.3 宏观经济展望
- 1.3.4 经济环境对半导体设备行业发展的影响分析
- 1.4 半导体设备行业社会环境分析
 - 1.4.1 中国电子信息产业发展
 - 1.4.2 研发经费投入增长
 - 1.4.3 其他相关社会因素
 - 1.4.4 社会环境对半导体设备行业发展的影响分析
- 1.5 半导体设备行业技术环境分析
 - 1.5.1 半导体行业技术迭代历程
 - 1.5.2 存储芯片制程演进
 - 1.5.3 尺寸缩减及3D结构化发展
 - 1.5.4 相关专利的申请情况分析
 - 1.5.5 半导体设备行业技术发展趋势
 - 1.5.6 技术环境对半导体设备行业发展的影响分析
- 1.6 半导体设备行业发展机遇与挑战

第2章：半导体行业发展及设备所处位置

- 2.1 半导体设备与半导体行业的关联
 - 2.1.1 半导体设备在半导体行业中的位置
 - 2.1.2 半导体设备对半导体行业发展的影响分析
- 2.2 半导体行业发展现状分析
 - 2.2.1 全球半导体行业发展分析
 - (1) 全球半导体行业整体规模
 - (2) 全球半导体行业结构分析
 - (3) 全球半导体行业区域发展分析
 - 2.2.2 中国半导体行业发展分析
 - (1) 行业整体发展情况

- (2) 半导体设计业发展
- (3) 半导体制造业发展
- (4) 半导体封装测试业发展

2.3 半导体行业发展趋势分析

第3章：全球半导体设备行业发展现状及趋势前景分析

3.1 全球半导体设备行业发展现状分析

3.1.1 全球半导体设备行业发展历程

3.1.2 全球半导体设备行业发展现状

- (1) 市场规模
- (2) 行业构成

3.1.3 全球半导体设备行业竞争格局分析

- (1) 区域竞争
- (2) 品牌竞争

3.2 全球主要区域半导体设备行业发展现状分析

3.2.1 全球半导体行业转移

3.2.2 中国台湾地区半导体设备行业发展分析

3.2.3 韩国半导体设备行业发展分析

3.2.4 北美半导体设备行业发展分析

3.2.5 日本半导体设备行业发展分析

3.3 全球半导体设备主要企业发展分析

3.3.1 应用材料 (Applied Materials, Inc.)

3.3.2 泛林半导体 (Lam Research)

3.3.3 荷兰ASML (Advanced Semiconductor Material Lithography)

3.3.4 东京电子 (TEL)

3.4 全球半导体设备行业发展趋势及经验借鉴

3.4.1 全球半导体设备行业发展趋势分析

3.4.2 全球半导体设备行业发展经验借鉴

第4章：中国半导体设备行业发展现状分析

4.1 中国半导体设备行业发展概述

4.1.1 行业发展历程分析

- 4.1.2 半导体设备行业发展特征分析
- 4.2 中国半导体设备行业发展现状分析
 - 4.2.1 半导体设备行业发展现状分析
 - 4.2.2 半导体设备行业供给分析
 - 4.2.3 中国半导体设备行业进出口市场分析
- 4.3 中国半导体设备行业发展痛点分析

第5章：半导体设备行业竞争状态及竞争格局分析

- 5.1 半导体设备行业投资、兼并与重组分析
 - 5.1.1 行业融资现状
 - (1) 国家集成电路产业大基金
 - (2) 投融资事件汇总
 - (3) 投融资所处阶段
 - 5.1.2 行业兼并与重组
 - (1) 兼并与重组现状
 - (2) 兼并与重组案例
- 5.2 半导体设备行业波特五力模型分析
 - 5.2.1 现有竞争者之间的竞争
 - 5.2.2 关键要素的供应商议价能力分析
 - 5.2.3 购买者议价能力分析
 - 5.2.4 行业潜在进入者分析
 - 5.2.5 替代品风险分析
 - 5.2.6 半导体设备行业五力模型总结
- 5.3 中国半导体设备行业竞争格局分析
 - 5.3.1 区域竞争
 - 5.3.2 企业竞争
- 5.4 中国半导体设备行业全球竞争力分析

第6章：中国半导体设备行业细分市场分析

- 6.1 中国半导体设备行业构成分析
- 6.2 中国半导体光刻设备行业发展分析
 - 6.2.1 半导体光刻工艺概述

6.2.2 半导体光刻技术发展分析

(1) 光刻技术原理

(2) 光学光刻技术

(3) EUV光刻技术

(4) X射线光刻技术

(5) 纳米压印光刻技术

6.2.3 半导体光刻机发展现状分析

(1) 光刻机工作原理

(2) 光刻机发展历程

(3) 光刻机市场规模

(4) 光刻机竞争格局

(5) 光刻机国产化现状

6.2.4 半导体光刻设备发展趋势分析

6.3 中国半导体刻蚀设备行业发展分析

6.3.1 半导体刻蚀工艺概述

6.3.2 半导体刻蚀技术发展分析

6.3.3 半导体刻蚀设备发展现状分析

6.3.4 半导体刻蚀设备发展趋势分析

6.4 中国半导体清洗设备行业发展分析

6.4.1 半导体清洗工艺概述

6.4.2 半导体清洗技术发展分析

6.4.3 半导体清洗设备发展现状分析

6.4.4 半导体清洗设备发展趋势分析

6.5 中国半导体薄膜沉积设备行业发展分析

6.5.1 半导体薄膜沉积工艺概述

6.5.2 半导体薄膜沉积技术发展分析

6.5.3 半导体薄膜沉积设备发展现状分析

6.5.4 半导体薄膜沉积设备发展趋势分析

6.6 中国半导体封装设备行业发展分析

6.6.1 半导体封装工艺概述

6.6.2 半导体封装技术发展分析

6.6.3 半导体封装设备发展现状分析

- 6.6.4 半导体封装设备发展趋势分析
- 6.7 中国半导体测试设备行业发展分析
 - 6.7.1 半导体测试工艺概述
 - 6.7.2 半导体测试技术发展分析
 - 6.7.3 半导体测试设备发展现状分析
 - 6.7.4 半导体测试设备发展趋势分析
- 6.8 中国半导体制造其他设备发展分析
 - 6.8.1 单晶炉设备
 - 6.8.2 氧化/扩散设备
 - 6.8.3 离子注入设备

第7章：中国半导体设备行业重点企业生产经营分析

- 7.1 半导体设备行业重点企业概况
- 7.2 半导体设备行业代表性企业案例分析
 - 7.2.1 中微半导体设备（上海）股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业经营状况分析
 - (3) 企业业务结构及销售网络
 - (4) 企业半导体设备业务布局
 - (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
 - (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析
 - 7.2.2 北方华创科技集团股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业经营状况分析
 - (3) 企业业务结构及销售网络
 - (4) 企业半导体设备业务布局
 - (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
 - (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析
 - 7.2.3 沈阳芯源微电子设备股份有限公司
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业经营状况分析
 - (3) 企业业务结构及销售网络

- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.4 杭州长川科技股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.5 苏州赛腾精密电子股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.6 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.7 北京华峰测控技术股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.8 武汉精测电子集团股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.9 北京屹唐半导体科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

7.2.10 上海微电子装备（集团）股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业经营状况分析
- (3) 企业业务结构及销售网络
- (4) 企业半导体设备业务布局
- (5) 企业半导体设备战略布局及最新发展动态
- (6) 企业发展半导体设备业务的优劣势分析

第8章：半导体设备行业发展前景预测与投资机会分析()

8.1 半导体设备行业投资潜力分析

8.1.1 行业生命周期分析

8.1.2 行业发展因素分析

- (1) 驱动因素
- (2) 阻碍因素

8.2 半导体设备行业发展前景预测

8.3 半导体设备行业投资特性分析

8.3.1 行业进入壁垒分析

8.3.2 行业投资风险预警

8.4 半导体设备行业投资价值与投资机会

8.4.1 行业投资价值分析

8.4.2 行业投资机会分析

8.5 半导体设备行业投资策略与可持续发展建议

8.5.1 行业投资策略分析

8.5.2 行业可持续发展建议()

部分

图表目录：

图表1：本报告的主要数据来源说明

图表2：2024-2030年半导体设备行业标准汇总

图表3：2024-2030年半导体设备行业发展政策汇总

图表4：2024-2030年半导体设备行业发展政策解读

图表5：2024-2030年半导体设备行业中长期规划汇总

图表6：2024-2030年半导体设备行业发展中长期规划解读

图表7：半导体行业技术迭代历程

图表8：存储芯片结构演变

图表9：中国半导体设备行业发展机遇与挑战分析

图表10：2024-2030年全球半导体产业销售额（单位：亿美元，%）

图表11：2024-2030年中国集成电路行业销售额（单位：亿元，%）

图表12：2024-2030年中国集成电路行业产量（单位：亿块，%）

图表13：2024-2030年中国集成电路行业细分领域销售额占比情况（单位：%）

图表14：2024-2030年中国集成电路设计业销售额和增长情况（单位：亿元，%）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/416392.html>